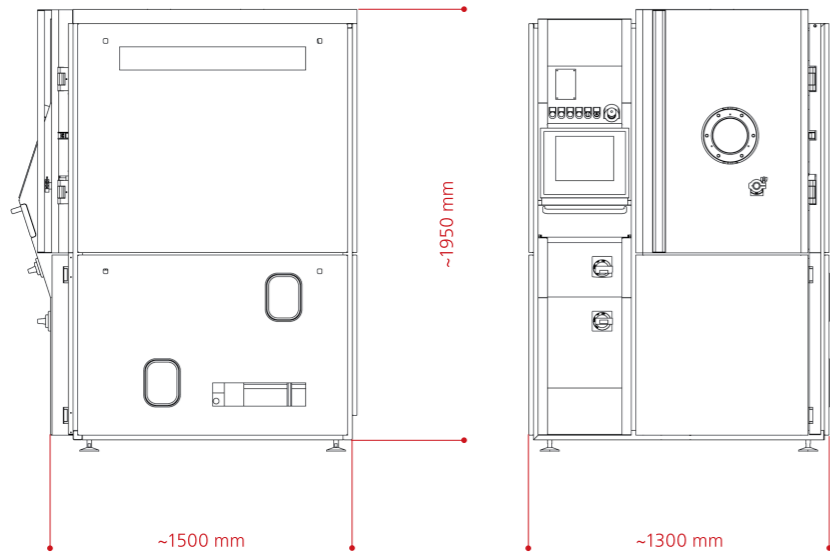


VLO 180 | VLO 300

适用于大批量生产的真空焊接系统

尺寸



关键数据

型号	VLO 180	VLO 300
应用领域	大批量生产	
加热板尺寸	540 x 410 mm ²	
	5块加热板	
	100 mm	
每层加热板承重	15 kg	
电源	N ₂ , H ₂ 高达 100%, N ₂ /H ₂ 95/5, HCOOH	
	3~/N/PE 230/400 V 50 Hz	
最大升温速率	15 l/min @ 15 - 25 °C	
	40 K/min	
	150 K/min	
真空度		
真空泵抽速	40 m ³ /h 或 65 m ³ /h	
	1200 kg	1500 kg

可选: 3~/N/PE 277/480 V 60 Hz

选项

- 100% H₂ 装置, 安全等级2级和尾气处理系统
- 集成完整的蚁酸鼓泡装置, 安全等级1级
- 6组热偶用于表面温度监控
- 适用于 VLO 300 高温选项 [高达 750 °C]

备注: centrotherm thermal solutions GmbH & Co. KG 保留随时根据需要对产品规格进行修改的权利, 恕不事先通知。| Z | H | VLO 300 | 1 | CN | 11 | 5 | ©centrotherm 2011

中国销售代理: 上海驰舰半导体科技有限公司
电话: + 86 (0) 21 60751826
邮箱地址: eiitech@eiitech.cn

centrotherm thermal solutions GmbH & Co. KG
Johannes-Schmid-Strasse 8
89143 Blaubeuren
Germany
Phone: +49 (0)7344 918 - 6794
Fax: +49 (0)7344 918 - 6387
infos@centrotherm-ts.de
www.centrotherm.cn

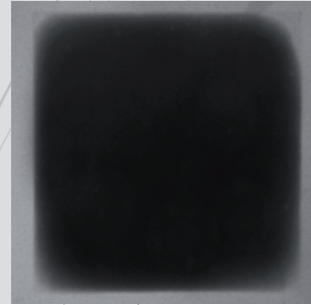


centrotherm
thermal solutions

Equipment
Process
Solutions

VLO 180 | VLO 300

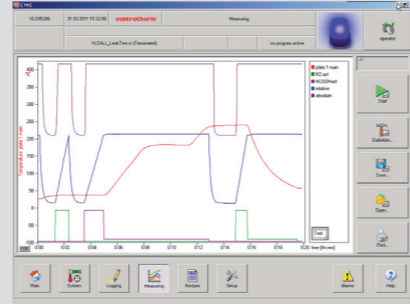
适用于大批量生产的真空焊接系统



空洞率小于2%



带视窗的门



简单容易使用的软件

centrotherm
thermal solutions

Equipment
Process
Solutions

VLO 180 | VLO 300

适用于大批量生产的真空焊接系统

描述

centrotherm VLO 180 或 VLO 300 真空焊接系统理想应用于大批量生产各种材料, 温度最高可达到 750 °C。

整合的加热和冷却热板可以单独控制。应用 VLO 180 或 VLO 300, 焊接区域的空洞率减少到小于2%而典型回流焊接范围为 20%。

使用各种气体诸如 [N₂, H₂ 100, N₂/H₂ 95/5], 允许微量助焊接和极少空洞焊接工艺, 该系统是理想的生产设备。centrotherm VLO 180 | VLO 300 选择使用蚁酸化学活化以达到更高要求的洁净的焊接工艺, 甚至在无额外助焊剂情况下也可使用无铅的焊膏或焊片。

工艺过程计算机与易操作的触摸屏结合在一起, 便于工艺资料的编辑和程序的存储。辅助功能可以通过以太网的 USB 接口与打印机, 外部存储设备和远程访问进行连接。

典型 应用场合

- 高级封装
- 功率半导体
- 微电子混合组装
- 光电封装
- 气密封装
- 晶圆级封装
- UHB LED 封装
- MEMS 封装

客户 效益

- 工艺温度可达 450°C
- 可选: VLO 300 HT 工艺温度可达 750°C
- 极好的温度均匀性
- 真空度可达 0.1 mbar
- 极短的工艺周期
- centrotherm 实验室可以提供样品的焊接试验
- 远程访问服务

